Низкотемпературные припои

Марка	Состав, масс. доли, %				Интервал плавления, °С		Паяемые материалы
	Sn	Pb	Ag	Прочее	начало	конец	
ПОС61	60–62	38–40		–	183	190	Лужение и пайка электро- и радиоаппаратуры, печатных плат, точных приборов с герметичными швами
ПОС40	39–41	61–59	–	–	183	238	Лужение и пайка электроаппаратуры
ПОС10	9–11	91–89	–	–	268	299	Лужение и пайка контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов, реле
ПОССу18–0,5	17–18	Основа	–	0,2–0,5 Sb	183	277	Лужение и пайка выводов электроламп
ПОССу8–3	7–8	Основа	–	2,0–3,0 Sb	240	290	Лужение и пайка в электроламповом производстве
ПОССр2	58–60	37,5–39,5	1,9–2,1	≤ 0,79 Sb	169	290	Пайка микромодулей, изделий с вакуумно-плотными соединениями
ПОССр3	96,7–97,3	–	2,7–3,3	–	220	220	То же
ПОСК50	49–51	Основа	–	17–19 Cd	142	145	Пайка меди и ее сплавов Соединение деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ50	24,5–25,5	24,5–25,5	–	49–50 Bi	90	92	То же
ПСр2,5	5–6	91–93	2,2–2,8	–	295	305	Пайка меди и ее сплавов